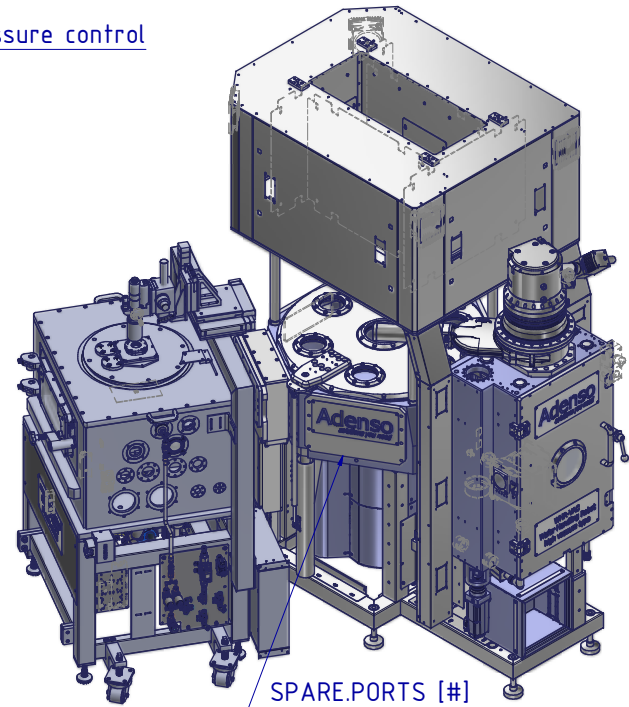
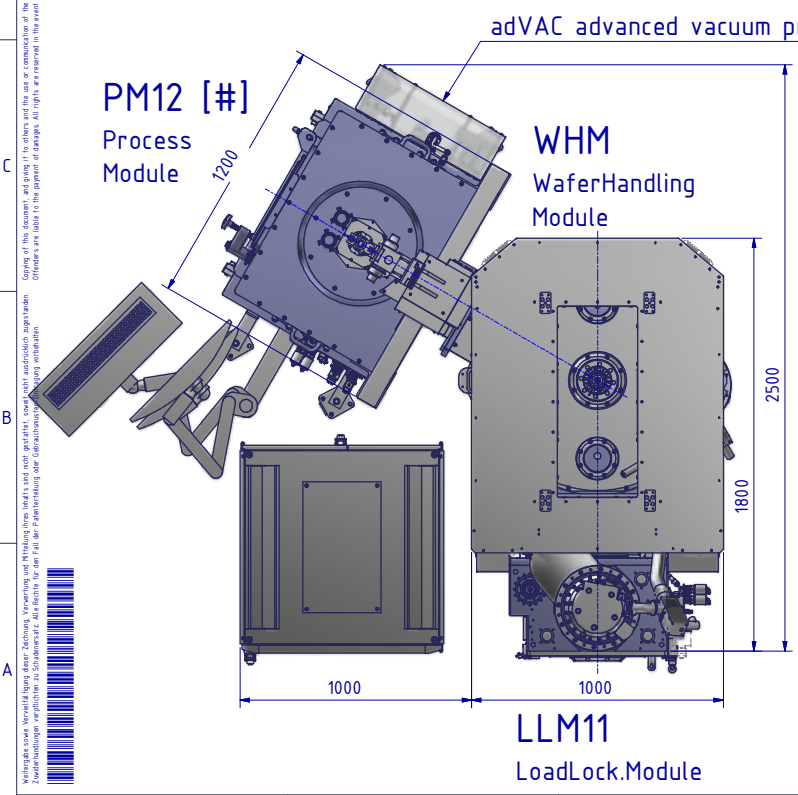
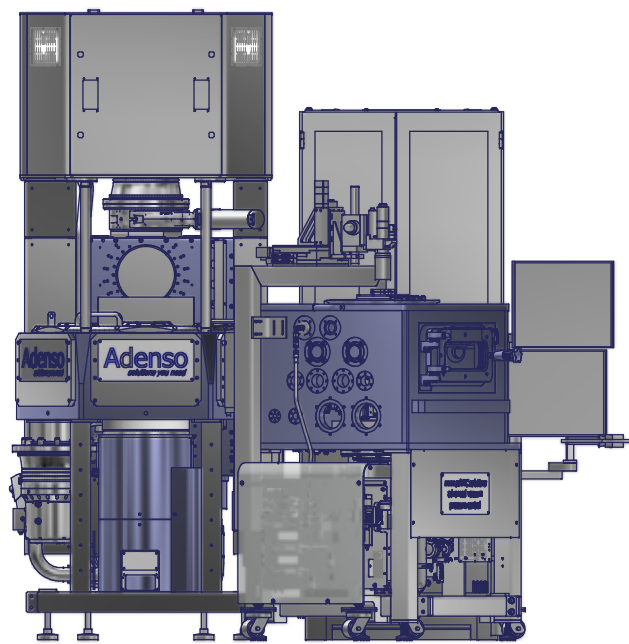
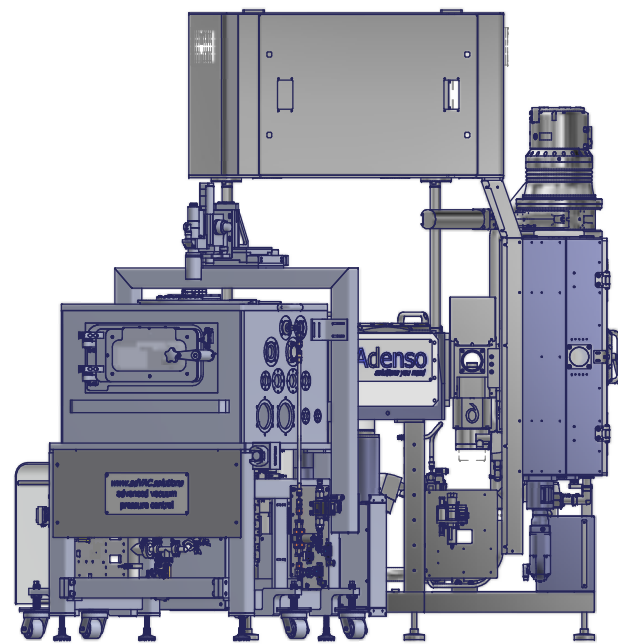
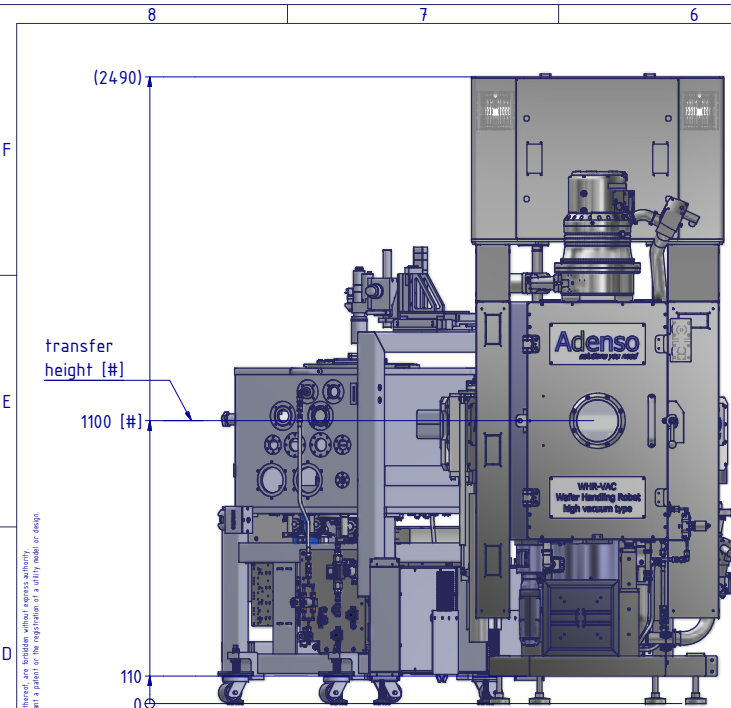




VACUUM PROBE SYSTEM [#]
device test on wafer level
w/ probeheads/single needles
w/ customized probecards

4x SPARE.PORTS for more
ProcessModules

adControl CLUSTER CONTROL SYSTEM:
stand-alone system, vacuum process control,
pneumatics, safety equipment, gatevalves, ...
Docking of customers process modules simply via
Adenso.Interface (Profibus, Profinet, Ethernet, ...)

www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768		Prüfmethode nach DIN 466-11	
⊙ Bohrungen / holes	0,1 mm			Längen und Winkelmaß Form und Lage Allg.-Tol. Schweißkonst. nach DIN ISO 2768		Toleranzierungsgrundsatz nach ISO 8015	
⊙ Gewinde / threads	0,1 mm			Längen und Winkelmaß Form und Lage		Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindungen) DIN EN ISO 5817 c	
⊙ Passungen / fits	0,01 mm						
projection ISO 128 - method 1				Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302 Vakuum-Dichtflächen keine Dichtungsverzug zulässig		Halbzeug:	
				Maßstab: 1:10		Masse: -	
				Halbzeug:		Material/Oberfläche:	
				Benennung:		WZG:	
				Datum		Name	
				Gezeichnet		BC	
				Freigegeben		20.02.2023	
						</	